



### GRAVUR-, SCHNITT- UND LOCHUNGSLASERSYSTEM

# PERSEO

CO<sub>2</sub>



Laser-Schneid- und -Graviersystem in X- und Y-Achse.

Mechanischer Aufbau mit verfahrbarer Brücke und in Z-Richtung verstellbarem Boden mit Fördereinrichtung. Ausgestattet mit CO<sub>2</sub>-Laserquellen von 50 bis 300 Watt in geschlossener Röhre (sealed-off).

Anwendungen: Schneiden und/oder Gravieren von Platten/Bögen, Halbzeugen oder Fertigprodukten, z. B.: Methacrylat, Kunststoffe, Acetat, Polyester, Holzwerkstoffe, Papier, Leder, organische Werkstoffe, synthetische Materialien.

Arbeit im Vektor- und/oder Rastermodus mit Schneid- oder Scan-Kopf (optional).

Die Anlage bietet hohe Bearbeitungsqualität, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit sowie Flexibilität im Einsatz.

Das **PERSEO**-System ist ideal für industrielle Anwendungen, bei denen konventionelle Maschinen nicht eingesetzt werden können.





## TECHNISCHE DATEN

# PERSEO

CO<sub>2</sub>

### LASERQUELLE

- Technologie: HF-CO<sub>2</sub>-Laserquelle
- Nennleistung: 50 - 100 - 200 - 300 W in geschlossener Röhre (sealed off)
- Frequenz: 0 - 50 kHz
- Kühlung: Wasser im geschlossenen Kühlkreislauf

### SYSTEM

- Steuermodul: eigene numerische Steuerung + Motorola Power-PC-Prozessor, 16/32/64 MB RAM, Compact Flash-Speicher (auf Anfrage)
- PC-Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional oder VISTA Business
- Software: Laser PLUS multilanguages, komplett UNICODE-kompatibel
- Unterstützte Vektordateiformate: DXF, DWG, PLT, HPGL, TTF, script ASCII
- Unterstützte Rasterdateiformate: BMP, JPG, TIFF, GIF, WMF
- Sondermerkmale:
  - ♦ Direkteingabe von mehrsprachigen Texten linear und kreisförmig (True Type und Monoline), mehrstufige Zähler, geometrische Formen, Strichcodes, Datenmatrix mit präziser Teilung und Positionierung innerhalb des Gravierbereichs o Benutzung von Scripts für den Import von externen Gravieraufträgen
  - ♦ Automatisches Management der optischen Aberrationskorrekturen
  - ♦ Dateimanagement 3D in STL-Größe
  - ♦ Cad Vecad integriert
  - ♦ Steuerung von Zusatzgeräten (Kamera, Caxys, XY-Tisch etc....)
- Gehäuse der Schutzklasse 1 - Kältekompressor zur Kühlung
- Lasersicherheit: Lasersystem der Klasse 1, CEI EN 60825 - 1



### VEKTORMODUS

- Arbeitsgeschwindigkeit in X-Y-Richtung: 1-1000 mm/s, programmierbar
- Verstellgeschwindigkeit in X-Y-Richtung: Max. 1000 mm/s
- Auflösung in X-/Y-Richtung: 0,01 mm / 0,01 mm
- Genauigkeit: +/- 0,1 mm über den gesamten Bereich
- Wiederholgenauigkeit bei fixierter Ebene: besser als 0,1 mm

### RASTERMODUS

- Rastergeschwindigkeit (Kopfverstellung): Max. 1000 mm/s
- Auflösung: bis 1200 dpi, programmierbar
- Graustufen: bis 256 Graustufen

### ALLGEMEINE MERKMALE

- Ebenheit der feststehenden Ebene +/- 1 mm
- Ebenheit der Förderebene +/- 2 mm
- Gewicht des verarbeitbaren Materials 50 kg/m<sup>2</sup>

### MODELLE

- Arbeitsbereich: Schneiden 730 x 500 mm / Scannen 630 x 500 mm
- Abstand der zum Fußboden: 1150 mm
- Maximale Materialstärke: 50 mm
- Abmessungen: B=1960 L=1970 H=1720 mm (ohne Bedienkonsole)
- Gewicht: 1000 kg
- Schneidkopf-Fokuslinsen: 3° - 5°
- Steuerung: über externen PC mit LaserPLUS-Softwareschnittstelle
- Stromversorgung: 380V +/-10% (3 Phasen, PE und Neutraleiter), 50 Hz
- Leistungsaufnahme maximal: 8000 VA-(100 W) 10000 VA-(200 W) 12000 VA-(300 W)

Änderungen vorbehalten.

### RETEC-AUTOMARK

Markier- und Befestigungssysteme GmbH  
Postfach 1546 / Gausstraße 3  
D-73230 Kirchheim/Teck

Telefon: +49 (0)7021-4896-0  
Telefax: +49 (0)7021-4896-20

E-mail: [info@retec-automark.de](mailto:info@retec-automark.de)  
Internet: [www.retec-automark.de](http://www.retec-automark.de)